



SMTA China East 华东高科技会议 Technical Conference

24th April 2019 (Wednesday) / 2019 年 4 月 24 日(星期三)

(CE19-TC1) Technology Conference / 高科技技术研讨会		
Conference Chairman/会议主席: Lin Dong 董林 Member of SMTA China Technical Advisory Committee / 中国 SMTA 技术顾问委员会委员 Customer Support Manager of Europlacer (Shanghai) Co., Ltd. / 优而备智自动化设备(上海)有限公司客户支援经理		
Venue/地点	Room No.6, B2, Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center 上海世博展览馆地下二层 6 号会议室	
Time/时间	Topic/主题	Speaker/演讲者
10:30 – 11:05	Management Overview of The Smart Factory (Industrie 4.0) Principles and Affects In Electronics Manufacturing 智能工厂(Industrie4.0)系统原理概述以及对电子制造业的影响 (CE19-TC1.1)	Sagi Reuven 萨奇鲁文 Mentor, A Siemens Business
11:05 – 11:40	New Generation Sn-Bi-Ag Low Temp Solder for SMT Assembly 新型 Sn-Bi-Ag 低温焊锡在电子组装的应用 (CE19-TC1.2)	Dr. Kuo-Shu Lin 林国书博士 Shenmao Technology Inc. 升贸科技股份有限公司
11:40 – 12:15	ACF and ACP Fine Pitch Assembly and Manufacturing Challenges ACF&ACP 细间距制程研发及制造挑战 (CE19-TC1.3)	Tim C.C. Pan 潘俊杰 Wistron InfoComm(Kunshan) Co.,Ltd. 纬创资通(昆山)有限公司
12:15– 13:45	Lunch Break / 午餐	
13:45 – 14:20	Impact of Stencil Quality&Technology On Solder Paste Printing Performance 钢网质量和工艺对焊膏印刷的影响 (CE19-TC1.4)	Evan Yin 殷雪冬 Indium Corporation(Suzhou)Co., Ltd. 镨泰科技(苏州)有限公司
14:20 - 14:55	An Update On High Reliability Lead-Free Solder Alloys 高可靠性无铅焊料的研究进展 (CE19-TC1.5)	Dillon Zhu 朱军桦 AIM Solder
14:55 - 15:30	pH Neutral Cleaning Agents – Market Expectation & Field Performance pH 中性清洗剂—市场的预期和现场实验表现 (CE19-TC1.6)	Jerry Ji 纪建光 ZESTRON Asia North ZESTRON 北亚分公司

All papers will be presented in Chinese 所有演讲者都将使用中文



SMTA China East 华东高科技会议 Technical Conference

25th April 2019 (Thursday) / 2019 年 4 月 25 日(星期四)

(CE19-TC2) Technology Conference / 高科技技术研讨会		
Conference Chairman/会议主席: Henley Zhou 周辉 Member of SMTA China Technical Advisory Committee / 中国 SMTA 技术顾问委员会委员 PME/Engineering Director of Dongguan NVT Technology Co., Ltd. / 东莞新能德科技有限公司工程部总监		
Venue/地点	Room No.6, B2, Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center 上海世博展览馆地下二层 6 号会议室	
Time/时间	Topic/主题	Speaker/演讲者
10:30 – 11:05	A new Halogen-Free Parylene for Robust Performance of Flexible, Rigid and High-Density Electronics In Water and Other Corrosive Environments 新型无卤聚对二甲苯, 有助于增强柔性、刚性及高密度电子元件在水中和其他腐蚀环境中的耐用性能 (CE19-TC2.1)	Dr. Rakesh Kumar 瑞克西 库马博士 Specialty Coating Systems, Inc. 特殊涂敷系统公司
11:05 – 11:40	High Reliability Lead-Free Alloys for Performance-Critical Applications 满足高性能要求应用的无铅合金 (CE19-TC2.2)	William Yu 余瑜 MacDermid Alpha Electronics Solutions 麦德美爱法电子部
11:40 – 12:15	Printing Process Design for High Density Low Space Component 细密间距元件的印刷工艺设计 (CE19-TC2.3)	Wisdom Qu 瞿艳红 Indium Corporation(Suzhou)Co., Ltd. 钢泰科技(苏州)有限公司
12:15 – 13:45	Lunch Break / 午餐	
13:45 – 14:20	Novel Fluxes With Decreased Viscosity After Reflow for Flip Chip and SIP Assembly 应用于倒装芯片和 SIP 封装的回流后黏度降低的新型助焊剂 (CE19-TC2.4)	Fiona Chen 陈芬 Indium Corporation(Suzhou)Co., Ltd. 钢泰科技(苏州)有限公司
14:20 - 14:55	The Effect of pH: Cleaning Agent Properties and Performance In Production pH 值对清洗剂特性和性能的影响 (CE19-TC2.5)	Daniel Gao 高伟 Shanghai KYZEN Cleaning Materials Co., Ltd. 上海凯晟清洁材料有限公司

All papers will be presented in Chinese 所有演讲者都将使用中文

Fee / 收费: RMB300/per day (including official invoice) / 人民币 300 元/天(包含发票)

Noted: 1. RMB540/two days for registering

2. Deadline for registration and Conference Fee Collection is 21 April

注: 1. 同时报名登记 2 天的会议可享受 9 折的优惠价(人民币 540 元)

2. 报名和收款截止日期是 4 月 21 日

Offer / 提供: 1. SMTA China Technology Conference Attendance Certificate / 中国 SMTA 高科技技术研讨会出席证书

2. Electronic Version of Conference Proceedings / 电子版本的论文集

3. Free Lunch Coupons / 免费午餐券

查询及报名: 电邮至 peggychen@smta.org.cn, 电话: +86 -21-56093010, 手机: +86-18202193148